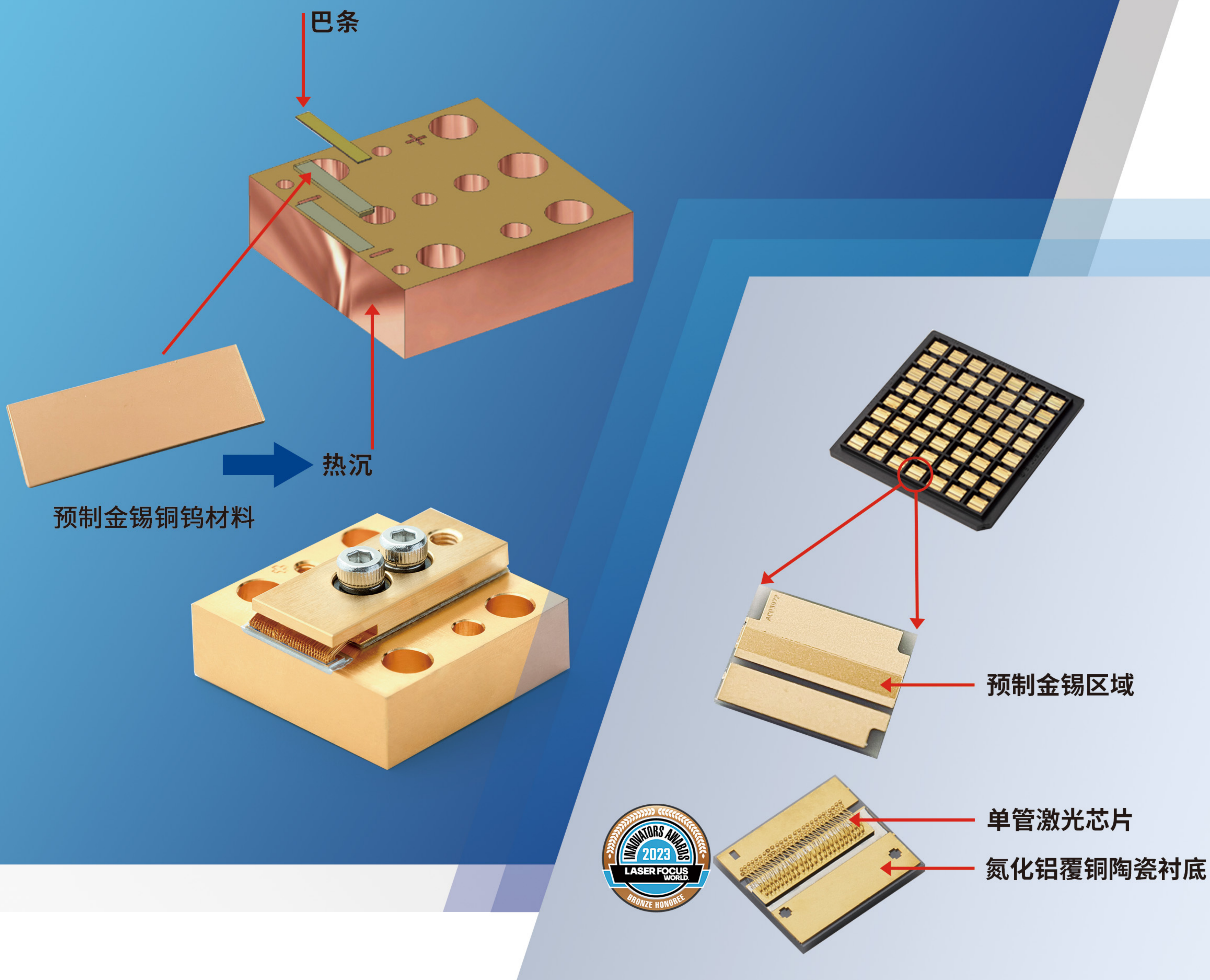


先进材料



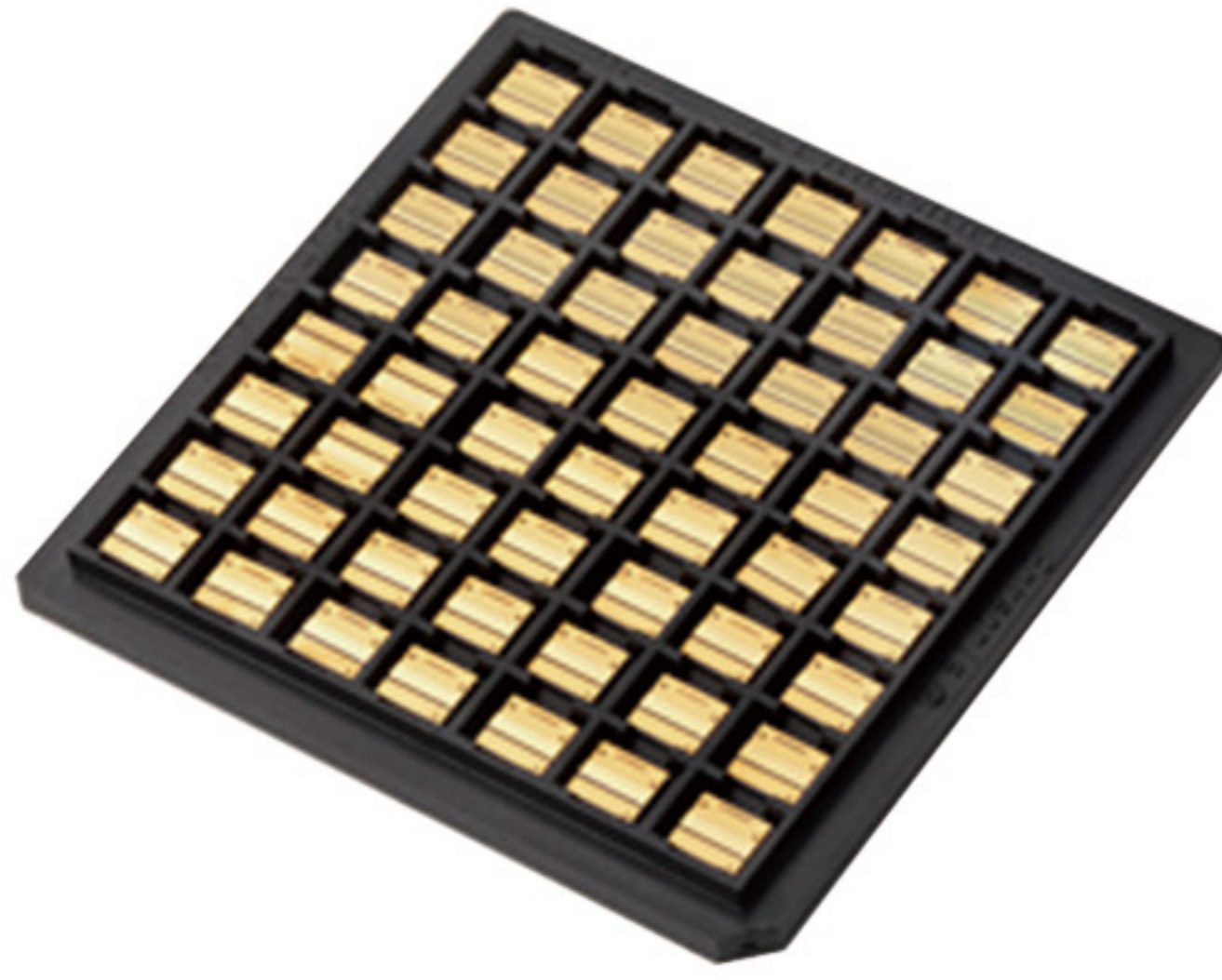
产品特点

- 低热阻效应
- 高CTE匹配设计
- 高精度加工表面
- 高精度晶圆级工艺
- 高热导率基材
- 低弯曲度效应

典型应用

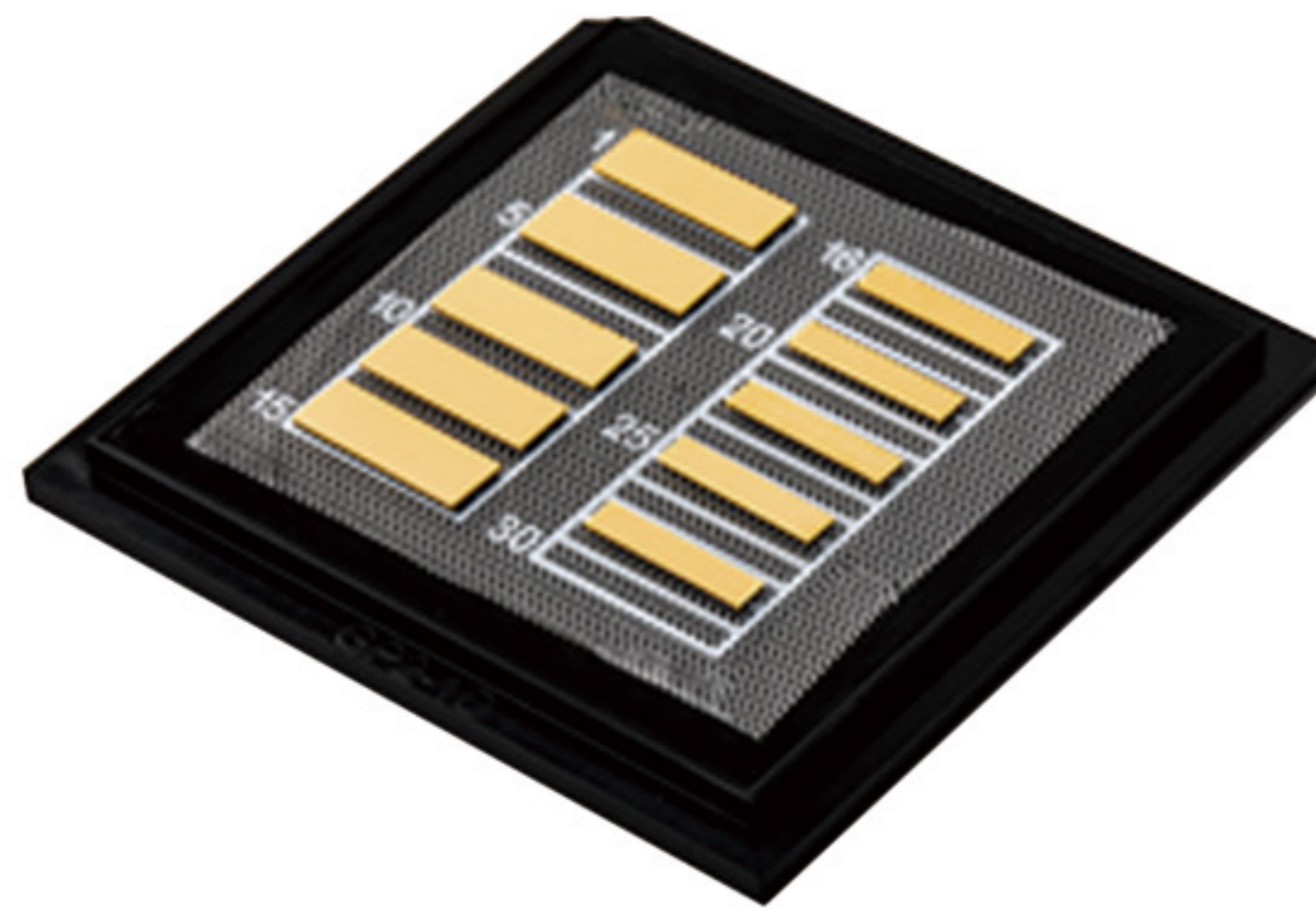
- 半导体激光芯片封装
- LED芯片封装
- 光通讯芯片封装
- IGBT器件封装
- 其他金属化需求

AMC预制金锡氮化铝衬底



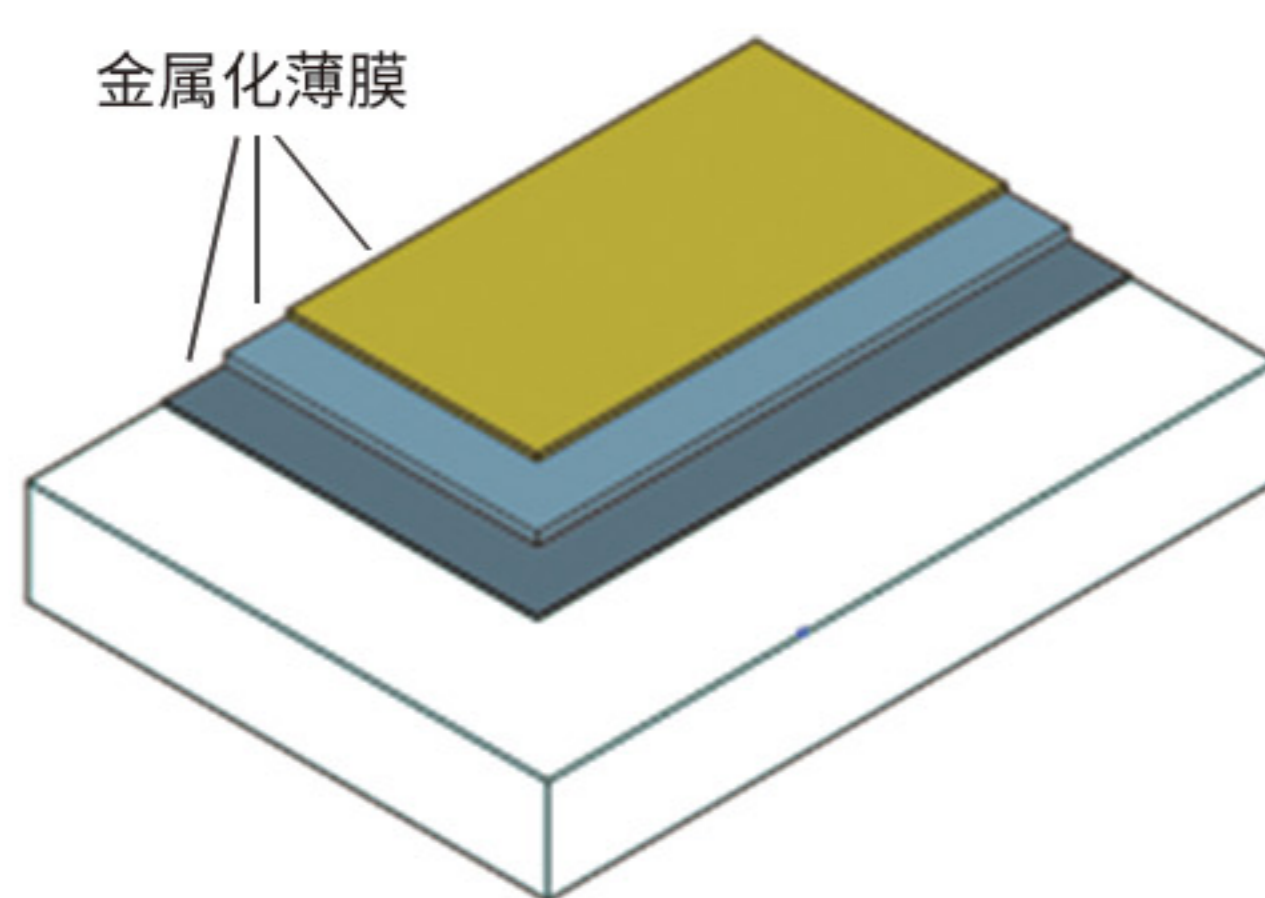
| 指标 | FL-AMC-4045 | FL-AMC-4048 | FL-AMC-4557 | |
|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 基板材质 | 氮化铝 | | | |
| 尺寸信息 | 长度(mm) | 4.50 | 4.80 | 5.75 |
| | 宽度(mm) | 4.00 | 4.05 | 4.50 |
| | 厚度(mm) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 金层厚度(μm) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| | 铜层Pullback (μm) | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
| 金锡参数 | 预制金锡厚度 (μm) | 6.0+/-1.0 | 6.0+/-1.0 | 6.0+/-1.0 |
| | 熔点(°C) | 280~320 | 280~320 | 280~320 |
| 关键表面参数 | 粗糙度(μm) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| | 平面度(μm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 热学参数 | 热阻(K/W) | ≤2.1 | ≤2.1 | ≤2.1 |

AMM预制金锡铜钨衬底



| 指标 | AMM-10217506 | AMM-10622503 | AMM-11541003 | |
|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| 基板材质 | 钨 (10%) 铜 (90%) | | | |
| 尺寸信息 | 长度(mm) | 10.2 | 10.6 | 11.5 |
| | 宽度(mm) | 1.75 | 2.25 | 4.10 |
| | 厚度(mm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| | 金层厚度(μm) | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 |
| 金锡参数 | 预制金锡厚度(μm) | 6.0+/-1.0 | 6.0+/-1.0 | 6.0+/-1.0 |
| | 熔点(°C) | 280~320 | 280~320 | 280~320 |
| | 镀膜面 | 双面 | 单面 | 单面 |
| 关键表面参数 | 粗糙度(μm) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| | 平面度(μm) | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 |

AMS金属化代工服务



| 金属化 | 工艺 | 厚度 (μm) | 表面粗糙度(um) | 平面度 (um) |
|------|-----|-----------|-----------|----------|
| 预制金锡 | PVD | 1~7, +/-1 | < 0.4 | < 2 |
| 镀金 | PVD | >0.15 | | |
| | 电镀 | >1 | | |
| 镀镍 | 电镀 | >1 | | |
| 镀钛 | PVD | >0.05 | | |
| 镀铂 | PVD | >0.05 | | |

公司简介

炬光科技成立于2007年9月，主要从事光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料（“产生光子”）、激光光学元器件（“调控光子”）的研发、生产和销售，目前正在积极拓展光子产业链中游的光子应用模块、模组、子系统（“提供光子应用解决方案”）业务，重点布局汽车应用、泛半导体制程、医疗健康。炬光科技已发展成为全球高功率半导体激光器及应用领域有影响力的公司和品牌，被中国光学学会激光加工专业委员会授予“高功率半导体激光产业先驱”称号。目前炬光科技在中国西安、东莞、海宁，德国多特蒙德，瑞士纳沙泰尔拥有生产基地和核心技术团队，并已通过ISO 14001、ISO 45001、ISO 9001和IATF 16949等质量管理体系认证。炬光科技为上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688167）。